

本件は、本日、メルテックスからも発表しています



2014年2月27日  
日立化成株式会社  
メルテックス株式会社

## 日立化成とメルテックスが無電解めっき薬品などの販売に関する協業契約を締結

日立化成株式会社(以下、日立化成)とメルテックス株式会社(以下、メルテックス)は、日立化成が製造するプリント配線板用無電解めっき薬品<sup>※1</sup>および表面処理剤<sup>※2</sup>を、メルテックスが日本国内(日立化成の既存顧客を除く)において独占的に販売する協業契約(以下、本契約)を締結しました。

近年、スマートフォン・タブレットに代表される電子機器の需要増加に伴い、半導体パッケージ基板を含むプリント配線板の世界市場は平均成長率3.2%<sup>※3</sup>が見込まれるなど、拡大が期待されています。半導体パッケージ基板や、スマートフォン・タブレットに使用されるプリント配線板においては「微細配線形成技術」「そり・寸法安定性」「高信頼性」などがテーマとなっています。特に「微細配線形成技術」「高信頼性」を実現する材料としてめっき薬品や表面処理剤の需要も年々、増加傾向にあります。

本契約は、両社における配線板プロセス材料事業の拡大を目的として締結されたものです。本契約により、メルテックスは、日立化成が生産するプリント配線板用無電解めっき薬品および表面処理剤を、一部顧客を除く国内で独占販売することができます。また日本を除く全世界においても、メルテックスは日立化成の無電解めっき薬品および表面処理剤を販売することができます。

日立化成では、銅張積層板や感光性フィルムといった配線板材料に加え、プリント配線板や半導体パッケージ基板に欠かせない高信頼性無電解めっき薬品や、プロセス材料である表面処理剤等の製造・販売を行っています。本契約により、メルテックスが有する日本、中国大陸、台湾地域、香港、東南アジアなどにおける幅広い販売網を活用して、日立化成のめっき薬品および表面処理剤の売上拡大を図ります。

メルテックスにおいては、従来から製造・販売を行っているプリント配線板や半導体パッケージ用のめっき薬品や表面処理剤に加え、本契約により、日立化成の製品をラインアップに加えることで、周辺材料と各種プロセス製品との最適化を行い、高付加価値のトータルプロセスとサービスの提供体制を強化して、海外の高密度プリント配線板市場を中心に売上拡大を図ります。

本契約の販売協業に加え、今後さらに求められる高密度微細配線板製造技術に関して、これまで両社が培ってきた製造ノウハウや開発技術を生かした新製品の共同開発なども視野に、協業体制の拡充も図っていく予定です。

※1 無電解めっき薬品: プリント配線板等の回路となる電解銅めっきの下地となるめっき薬品

※2 表面処理剤: プリント配線板等の金属表面の粗化等を行い、絶縁材料等との密着性や信頼性を向上させる薬品

※3 出典: Prismark 2012~2017年 年平均成長率

= 報道関係のお問い合わせ先 =

### 日立化成株式会社

コーポレートコミュニケーションセンター 広報担当: 木村 哲夫、施政

電話: 03-5533-7147

### メルテックス株式会社

グローバル営業部 事業企画課 コミュニケーショングループ 広報担当: 二神 英祐、三浦 弘嗣

電話: 048-665-2123

以上